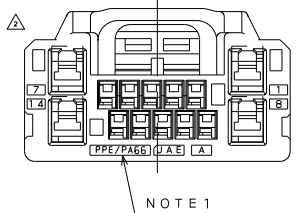
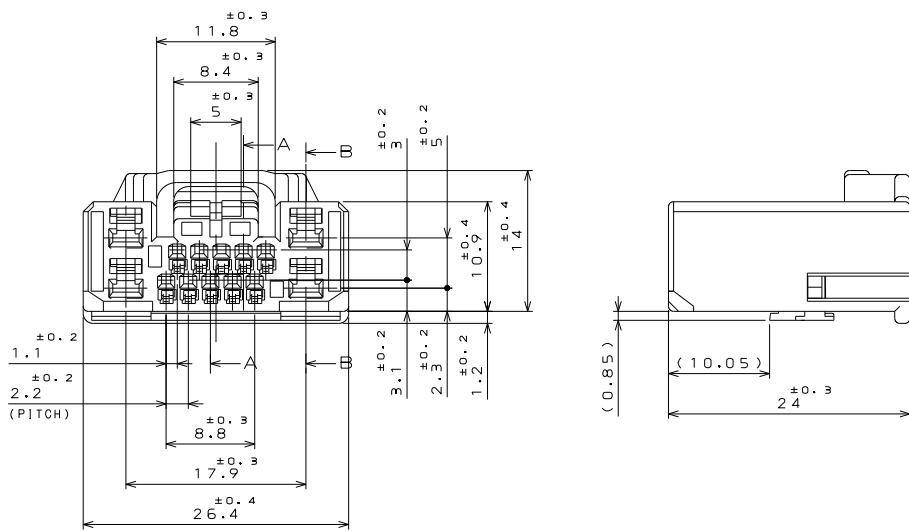
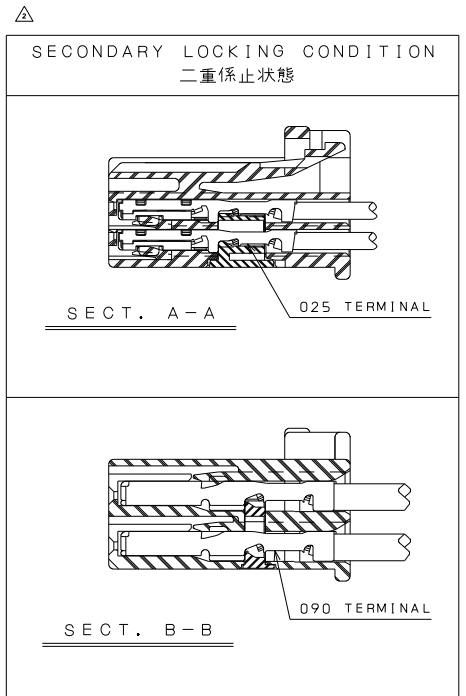
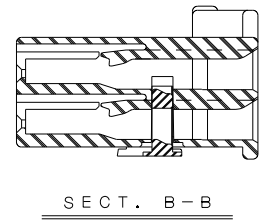
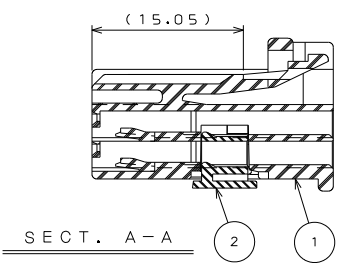
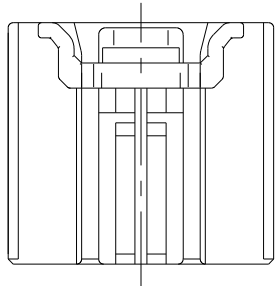


L1Z001RS
(DRAWING NO.)

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	21.Oct.2008	066693	ADDED TERMINAL MATERIALS PLATING LIST		Y.WATANABE	K.MIYAMOTO	T.MORINO
3	14.Nov.2008	066892	CHANGE OF TERMINAL MATERIALS PLATING LIST		Y.WATANABE	K.MIYAMOTO	T.KUME



TERMINAL INSERTION CONDITION (REF.)
端子挿入状態 (参考)

TABLE1: 025 TERMINAL MATERIALS AND PLATING LIST (端子材料・メッキ設定コード表)

CODE	PART TITLE	SJ No.	MATERIALS	PLATING	APPLICABLE WIRE
S	M34S75C4F1	038527	HIGH CONDUCTIVITY COPPER ALLOY 高導電性銅合金	TIN PLATING スズめっき	CHFUS 0.22sq. AVSS 0.3sq. CHFUS 0.35sq. ALL CAVITIES CAN BE APPLIED. 全キャビティ対応
M	M34S75C4F2	038528			CHFUS 0.5sq. AVSS 0.5sq. CAVS 0.5sq. CHFUS 0.75sq. CHFUS 0.75sq. ALL CAVITIES CAN BE APPLIED. 全キャビティ対応
X	M34S75C4F5	109336			CHFUS 0.13sq. ALL CAVITIES CAN BE APPLIED. 全キャビティ対応

NOTE1. MATERIAL MARK "PPE+PA66" IS INDICATED AS SHOWN.
注1. 図示の位置に材料表示"PPE+PA66"を行う。

2	RETAINER	1	PPE+PA66 (ALLOY)	COLOR: BLACK
1	HOUSING	1	PPE+PA66 (ALLOY)	COLOR: GRAY
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH
仕様書 (SPECIFICATION)	第1版 (ORIGINAL DATE)	2	30.Oct.2003	尺度 (SCALE)
JACS-1754 △ J AHL-1754				2:1
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	角度 (ANGLES)	製図 DR.	担当 CHK.	シリーズ (SERIES)
寸法 (DIMENSION)	° ±		A.KIMURA	MX34
. ±0.8	X° ±	査閲 APPD.	N.TOUDOU	名称 (TITLE)
.X ±0.4	X°X ±	承認 APPD.	T.TOTANI	MX34014SFA
.XX ±0.1	.XXX ±			質量 (MASS)
				4.0g

日本航空電子工業株式会社
JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
図面番号 (DRAWING NO.)
SJ100211

DCF-C-212F (05.08)

